

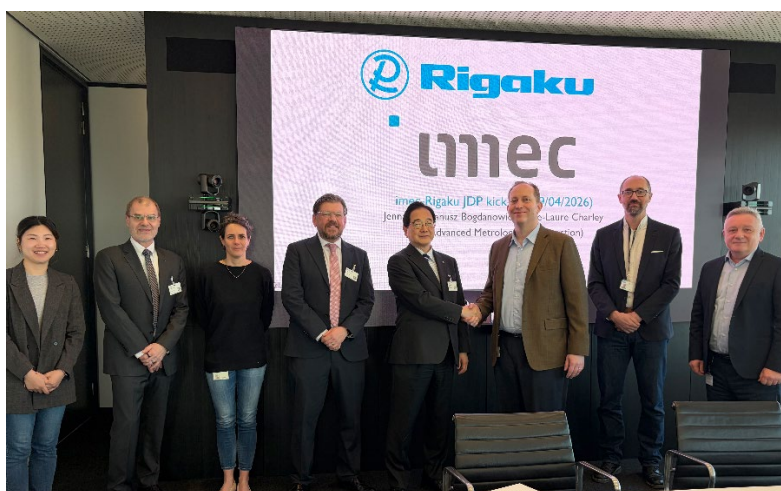
2026 年 5 月 12 日

プレスリリース

リガク・ホールディングス株式会社

リガク、世界最高水準の研究基盤を活用し、次世代半導体計測技術の開発を加速

リガク・ホールディングスのグループ会社で、X 線分析装置の世界的ソリューションパートナーである株式会社リガク(本社: 東京都昭島市 代表取締役社長: 川上 潤、以下「リガク」)は、グローバルな研究環境を活用し、次世代半導体向けの計測技術の開発を拡大します。



▲4/9 に行われた調印式の様子

リガクは、ベルギーに本部を置く世界的な半導体研究開発機関である imec との協業を継続し、新たに 3 年間の開発プログラムを締結しました。この協業を通じて、リガクは 3D デバイス計測、極薄膜および微量元素の高感度検出、ならびに微小欠陥の非破壊検査などを含むコア X 線技術をさらに高度化していきます。

GAA/CFET^{※1}といった先進的な構造設計への移行や、メモリの高密度化が進むにつれて、半導体デバイスの製造プロセスはますます複雑化しています。これに伴い、安定した量産を支えるための高精度かつ非破壊での計測・検査技術に対する需要が一層高まっています。リガクは、こうしたニーズに応えるべく、高い付加価値を持つ差別化された計測ソリューションを提供しています。

本開発プログラムでは、以下の分野に注力します。

【注力分野】

- 先端ロジック: CFET 構造に対応した計測・検査技術
- レチクル計測: EUV 露光^{※2}に用いられるフォトマスクの劣化評価
- 先端配線・パッケージ: アドバンスドパッケージ^{※3}の非破壊検査
- 先端メモリ: 次世代メモリの 3D DRAM における微細構造の形状評価

先端 AI 半導体分野において、リガクの計測・検査装置の SAM (Serviceable Available Market) は、2030 年に約 10 億米ドル規模に達すると見込まれています。リガクは、この成長市場に向けて、他社にはない高付加価値製品を順次投入し、当該 SAM において 50% のシェア獲得を目指します。

Imec との協業強化は、この成長市場において計測・検査という高付加価値領域での競争優位性を高め、中長期的な事業成長につなげる取り組みです。

※1: GAA/CFET: 電気の流れを制御する部品(トランジスタ)を立体的に配置・構造化することで、より小さく、高性能にする技術

※2: EUV 露光: 最先端の半導体を作るために欠かせない、超微細な回路を描く光の技術

※3: アドバンスドパッケージ: 複数の半導体チップを高密度に組み合わせ、性能向上や省電力化を実現する実装技術



【リガクグループについて】

リガクグループは、X線分析をコアに熱分析等も含む先端的な分析技術で社会をけん引する技術者集団です。産業・研究用分析のソリューションパートナーとして1951年の創業以来、136の国と地域のお客様と共に成長を続けています。日本国内で極めて高いシェアを誇り、海外売上は約70%に達しています。応用分野は、半導体や電子材料、電池、環境・エネルギーからライフサイエンスまで日々拡大中です。世界で2,000名超の従業員が「見るチカラで、世界を変える」イノベーションの実現に取り組んでいます。詳しくは rigaku-holdings.com をご覧ください。

【リリースに関するお問い合わせ】

リガク・ホールディングス株式会社 コミュニケーション部 部長 姫野 佐和

TEL: 090-6331-9843 e-mail: prad@rigaku.co.jp